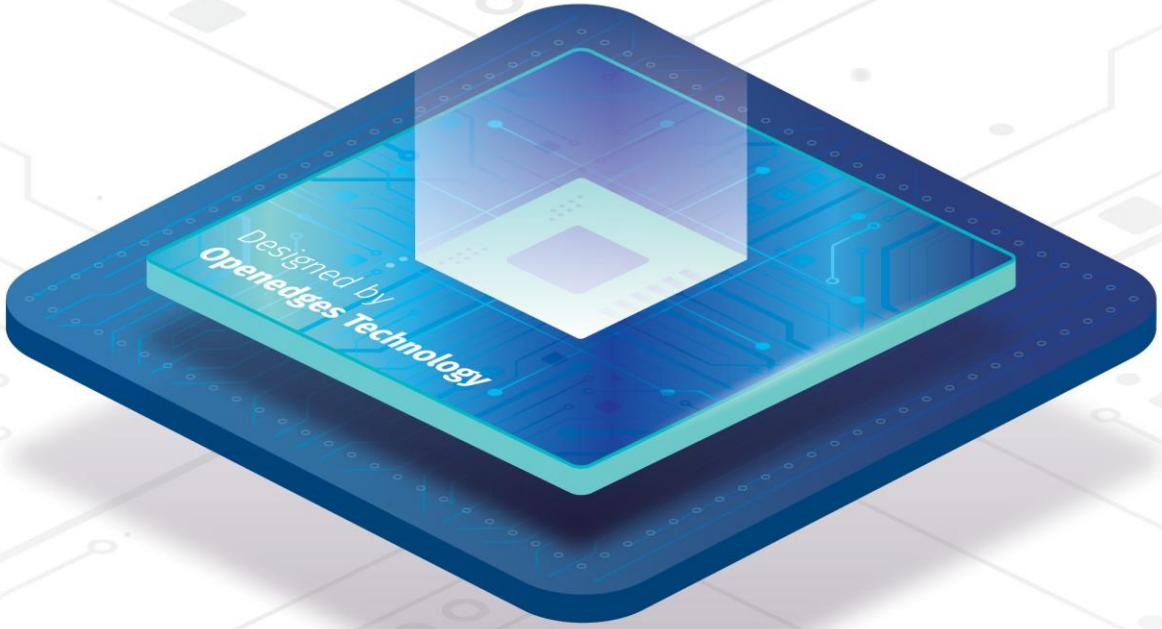
AI for Everyone, Everywhere



OPENEDGES
Technology, Inc.

Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서 정보 제공을 목적으로 오픈엣지테크놀로지 주식회사 (이하 "회사")에 의해 작성됐으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)'등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 경영 환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장 환경과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대해 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 하지 않으며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

OPENEDGES
Technology, Inc.

The Future of AI Computing

Table of Contents

Prologue
CPU, GPU, NPU 등 SoC에 들어가는 시장성으로 설계/검증된 기능 블록

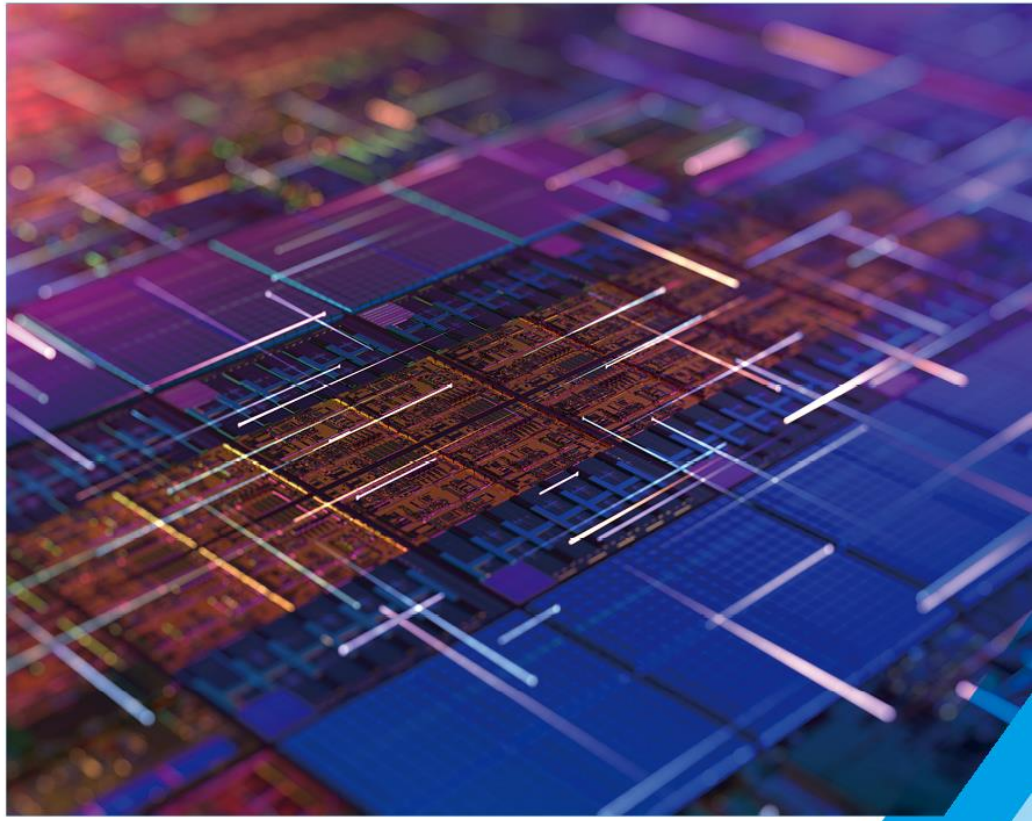
01
시스템 반도체 시장의 구조적 성장

02
국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업, 오픈엣지테크놀로지

03
'23년 1분기 경영실적

Prologue

오픈엣지테크놀로지 사업 영역



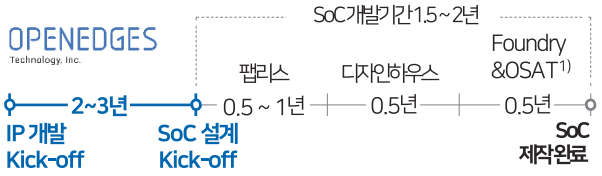
오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ①

OPENEDGES Technology, Inc.

반도체 IP는 AI 반도체를 포함한 SoC (System on Chip)의 개발 기간 단축과 비용 절감 및 천억 원 이상 규모의 개발 실패의 위험을 경감시키는 높은 수준의 기술력이 요구되는 Ready-made 솔루션

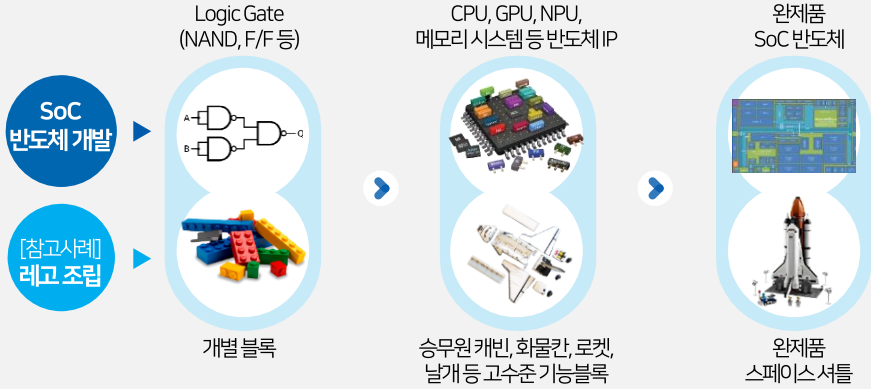
반도체 IP란?

CPU, GPU, NPU 등 SoC에 들어가는
사전적으로 설계/검증된 기능 블록



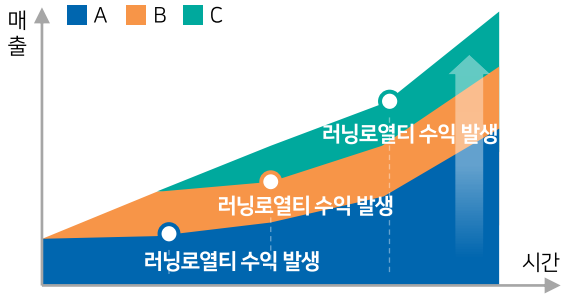
*주1) Outsourced Semiconductor Assembly and Test (패키징 등 후공정 업체)

Fabless 업체의
SoC 반도체 설계 시간 및 비용 단축



반도체 IP 사업의 수익구조

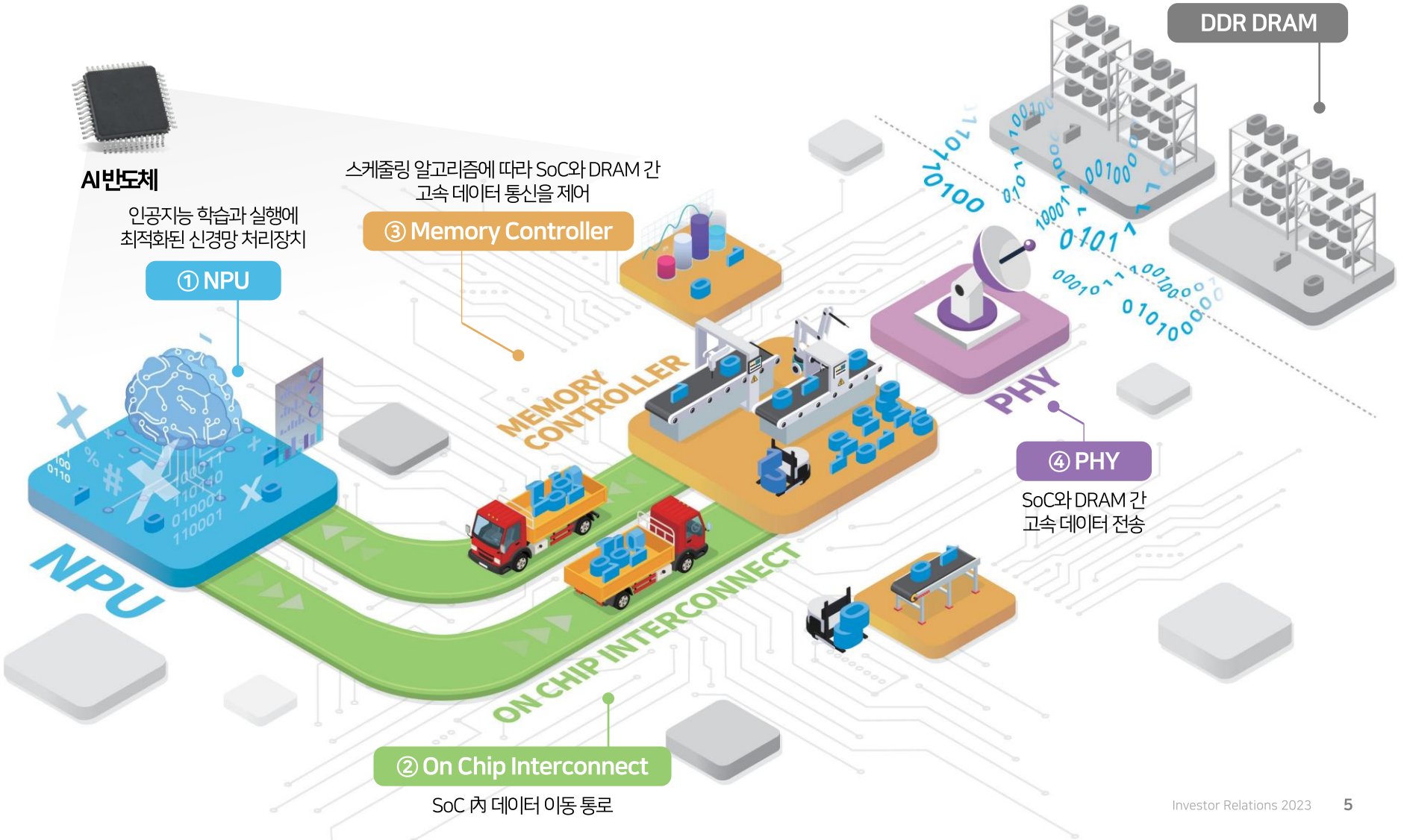
※반도체 IP 업계는 높은 기술장벽으로 소수 플레이어의 과점시장



오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ②

OPENEDGES Technology, Inc.

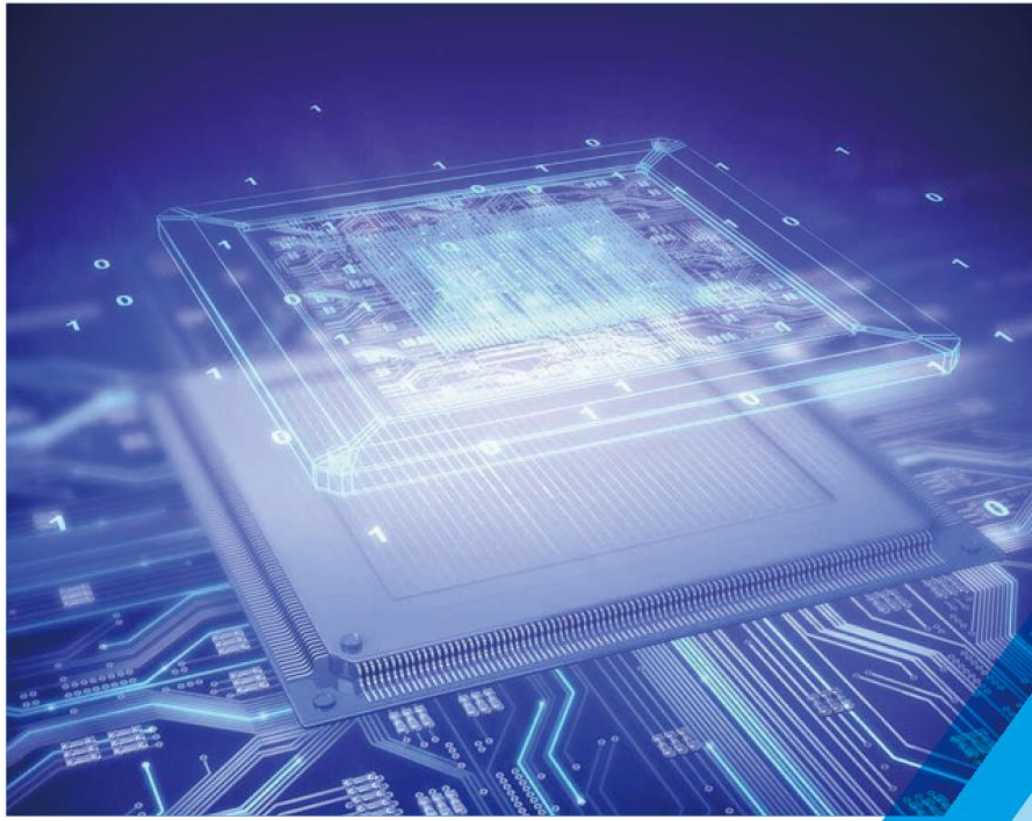
AI 반도체의 구동 기반이 되는 통합 IP 솔루션 설계 및 제공



01

시스템 반도체 시장의 구조적 성장

01. AI반도체 및 IP 시장 성장
02. 반도체 IP 설계업체의 역할
03. 시스템 반도체 IP 설계 중요성 확대
04. 국내 시스템 반도체 투자 본격화

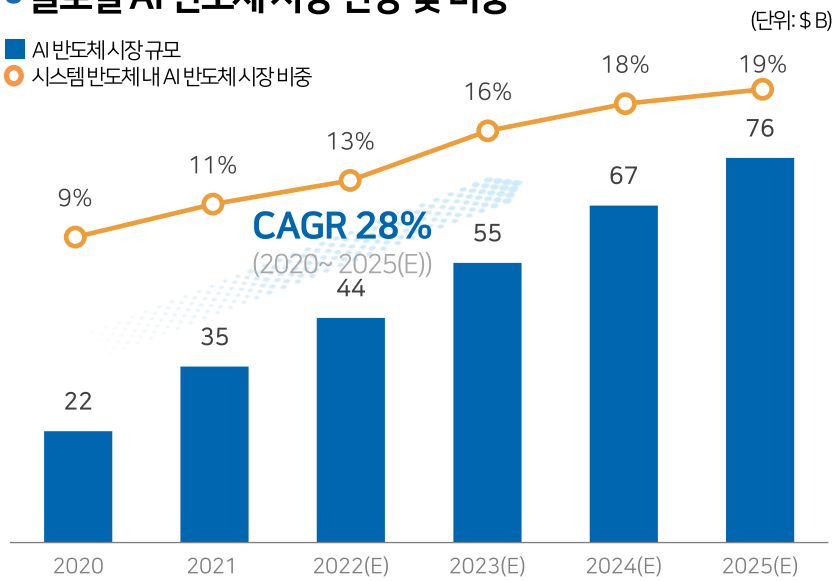


01 | AI반도체 및 IP 시장 성장

AI반도체와 IP시장의 견조한 성장세 지속

2018~2023년 글로벌 반도체 시장 전망

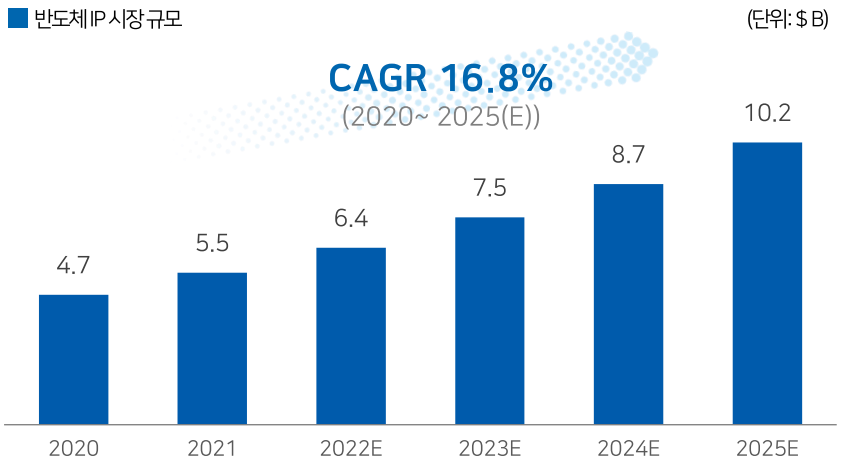
글로벌 AI 반도체 시장 전망 및 비중



※ Source: AI Semiconductor (Gartner , May 2022)

반도체 IP 시장 전망 및 경쟁 현황

업체명	2022 매출 ($ M)	CAGR ('18 ~ '22)
arm	2,742	9%
SYNOPSYS	1,315	16%
cadence	358	14%
OPENEDGES Technology, Inc.	7.7	107%
Others		11%
Total		14%



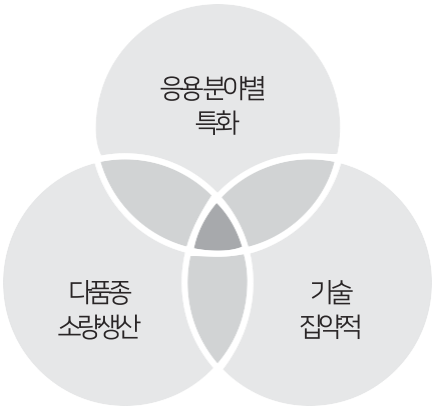
※ Source: IPnest 2022.05월, Press Clipping

02 | 반도체 IP 설계 업체 역할

OPENEDGES Technology, Inc.

반도체 IP 기업은 팹리스 및 디자인하우스가 필요로 하는 기능 블록을 선제적 개발 및 공급

시스템반도체의 특성



- 검증된 Track Record 필수
- 고객 맞춤형 제품 공급
- 우수 설계인력, 설계기술 필수

시스템반도체 과정內 IP설계 공정

	반도체 IP 설계 업체	팹리스 (Fabless)	디자인 하우스	파운드리 (Foundry)	(O)SAT[1]
주요 업무	반도체 주요 기능블록 설계	반도체 칩 설계 (Frontend 설계 담당)	반도체 칩 설계 외주 (Backend 설계 담당)	반도체 칩 제조 (Wafer 공정 업체)	후공정 담당 (패키징 업무)
Player 수	16개 기업 과점 시장	3,000개 이상	N/A[2]	Top 10 M/S 97% 차지	Top 25 M/S 50% 차지
규모	$6B *기업당시장파이최대규모	$120B	N/A	$82B	$42B
주요 업체	OPENEDGES Technology, Inc., arm, SYNOPSYS, cadence	Qualcomm, NVIDIA, BROADCOM, MEDIATEK, AMD	GUC, GAONCHIPS, ASICLAND	tsmc, SAMSUNG, GLOBALFOUNDRIES, UMC	ASE GROUP, Amkor Technology, JCET, SPIL

* 주1) (Outsourced) Semiconductor Assembly and Test: 반도체패키지 조립 및 테스트 업체로 웨이퍼 공정 이후 후공정 담당
주2) Design House 시장은 초기 형성 단계로 공신력 있는 시장 규모 데이터 부재

03 | 시스템 반도체 IP 설계 중요성 확대

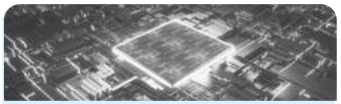
OPENEDGES Technology, Inc.

시스템 반도체 설계 / 제작비용 급증 → 검증된 IP 업체의 중요성 부각

국내 시스템 반도체 IP설계 산업 동향

Device 별
시스템반도체 IP 적용 확대

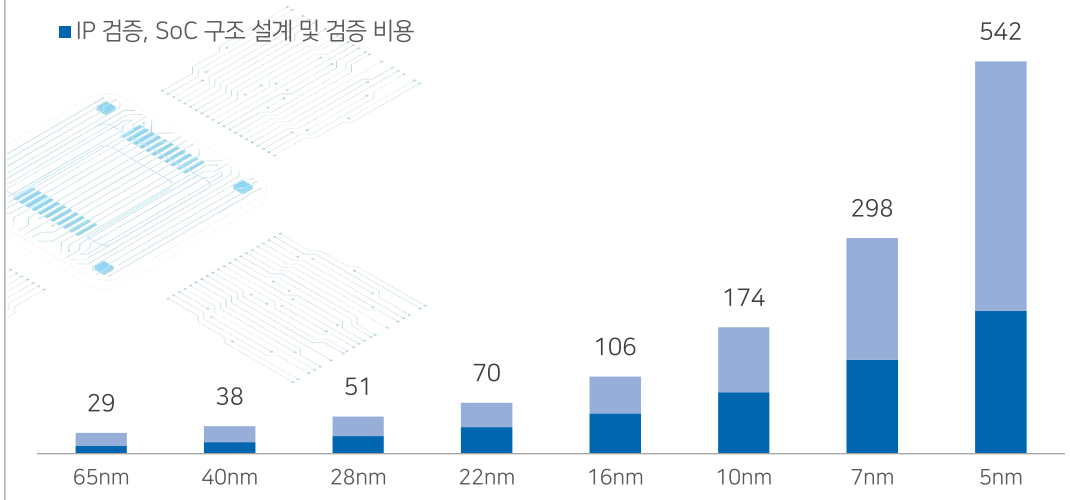
반도체 고집적화·미세화로
IP 가격 급등



리스크 최소화를 위한
검증된 IP 선호도 증가

공정별 시스템 반도체 설계 / 제작 비용

(단위: $ M)



※ 출처: IBS (International business strategies)

04 | 국내 시스템 반도체 투자 본격화

OPENEDGES Technology, Inc.

민관 합작의 대규모 투자로 국내 시스템 반도체 시장 성장 본격화
→ 국내 유일 반도체 공급 업체로서 수혜 기대

정부 정책적 지원

'반도체 초강대국 달성전략' 발표 ('22.07.21)

기업 투자 총력 지원 5년간 340조원 이상 투자 달성	**민관 합심 인력 양성** 10년간 인력 15만 + α명 공급
시스템 반도체 선도 기술 확보 글로벌 시장점유율 현재 3% → '30년 10%	**견고한 소부장 생태계 구축** 자립화율 현재 30% → '30년 50%

주요 투자 계획 (총 3.7조 원)		
	팹리스 칩 설계 판매 지원	1조 5,000억 원
	AI 반도체	1조 2,500억 원 ('22~'29)
	차량용 반도체	5,000억 원 ('24~'30)
	전력 반도체	4,500억 원 ('24~'30)

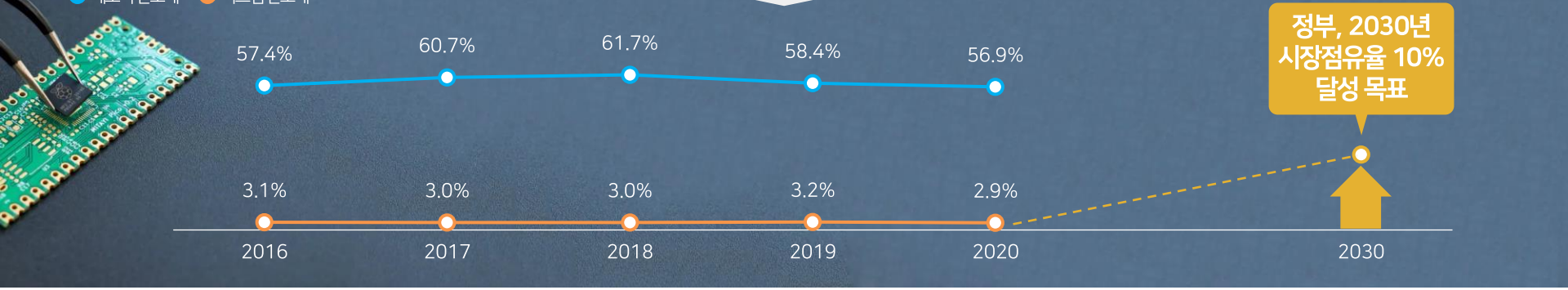
삼성전자 시스템 반도체 투자

'역동적 혁신성장을 위한 삼성 미래준비' 발표 ('22.05.24)

고성능/저전력 AP, 초고속 통신 반도체, 팹리스 시스템반도체 및 이미지센서 등 투자 계획 발표

반도체 및 미래 신사업 육성에 5년 간 **450조 원** 투자
(국내 투자 360조 원 계획)

한국 반도체, 글로벌 시장점유율 추이



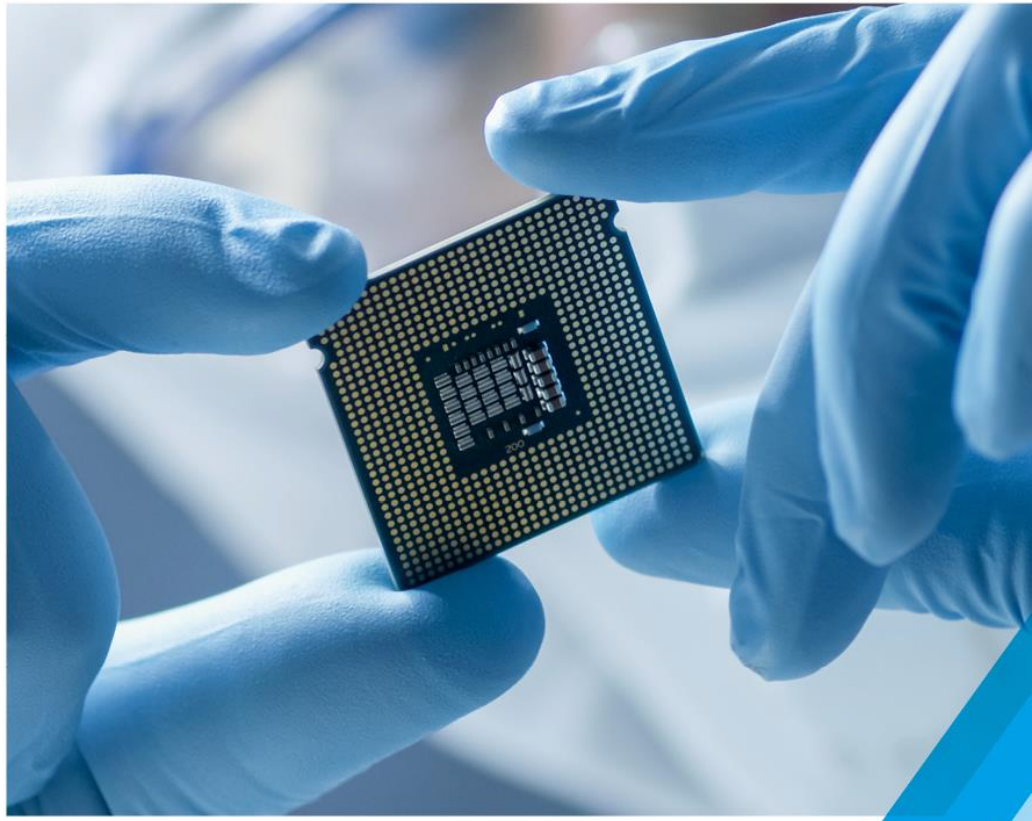
※ 출처: OMDIA

AI for Everyone, Everywhere

02

국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업, 오픈엣지테크놀로지

01. 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary
02. 글로벌 최고 수준의 Manpower
03. 업계 최고 수준의 기술경쟁력
04. 검증된 글로벌 Track Record
05. 글로벌 기업과의 전략적 Partnership



01 | 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary

OPENEDGES Technology, Inc.

오픈엣지는 AI 반도체 IP 시장의 글로벌 리더가 되기 위한 핵심 성공요인을 확보

01

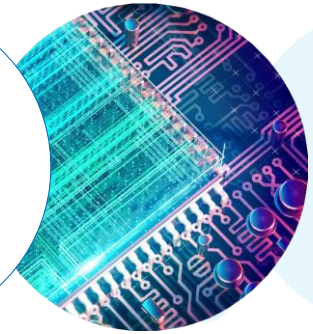
글로벌 최고수준의
Manpower

★★★

02

업계 최고수준의
기술경쟁력

★★★



OPENEDGES
Technology, Inc.

03

검증된
글로벌 Track Record

★★★

04

글로벌 기업과의
전략적 Partnership

★★★

02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower ① 국내

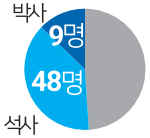
삼성전자 / 하이닉스 등에서 20년 이상 경력을 보유한 업계 최고 수준의 전문가로 구성된 리더십

전사 R&D 인력현황

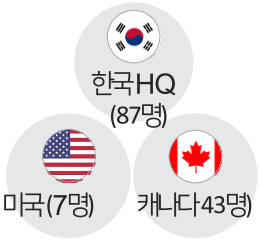
총 인원(137명)의 **83%**

114명 R&D 인원

R&D 인력 중 석박사(57명) 비중 **50%**



지역별 현황



이성현
대표이사/CEO

SAMSUNG | SAMSUNG ADVANCED INSTITUTE OF TECHNOLOGY

서울대학교 전기·컴퓨터공학 박사 수료
'17~現 오픈엣지테크놀로지㈜ 대표이사
'08~'15 삼성전자 수석연구원 (Exynos 개발)
'07~'08 삼성종합기술원

최정환
NPU팀장

SK hynix | SAMSUNG

Purdue대학교 전기 및 컴퓨터공학 박사
'18~現 오픈엣지테크놀로지㈜ NPU팀장
'15~'18 SK 하이닉스 수석연구원
'09~'14 삼성전자 Architecture Lab 파트장

김수호
PHY팀장

SK hynix | SAMSUNG

성균관대학교 전기공학 석사
'21~現 오픈엣지테크놀로지㈜ PHY팀장
'18~'21 SK 하이닉스 NAND IP 개발팀장
'98~'17 삼성전자 수석연구원

정성훈
System Architecture 팀장

Imagination | DM테크놀로지 | Chips&Media

경북대학교 전자전기공학 학사
'18~現 오픈엣지테크놀로지㈜ SA팀장
'13~'18 Imagination Tech. Lead Engineer
'03~'13 DM테크놀로지, 칩스앤미디어

황인조
R&D센터장/CTO/ Co-founder

Codeholics/codeholics | 대우전자 | Chips&Media

서울대학교 전기공학 석사
'17~現 오픈엣지테크놀로지㈜ CTO
'10~'15 코드홀릭스 CTO
'00~'10 대우전자, 칩스앤미디어

문상훈
Memory controller 팀장

SK hynix | SAMSUNG

서울대학교 컴퓨터공학 석사
'18~現 오픈엣지테크놀로지㈜ MC팀장
'17~'18 SK 하이닉스 Memory System연구소 파트장
'00~'16 삼성전자 AP개발팀 파트장

김대우
Verification 팀장

SAMSUNG | MIDAS

서울대학교 건축학 석사
'22~現 오픈엣지테크놀로지㈜ Verification팀장
'05~'22 삼성전자 Digital Technology팀 파트장
'01~'05 MIDAS IT

김현규
NoC 팀장

Chips&Media | adc

고려대학교 컴퓨터시스템공학 박사
'21~現 오픈엣지테크놀로지㈜ NoC팀장
'09~'21 칩스앤미디어 SW개발팀장
'00~'09 에이디칩스

※ 2023년 2분기말 기준

02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower ② 해외 법인

OPENEDGES Technology, Inc.

글로벌 선도기업 출신으로 구성된 자회사 R&D 인력 확보

한국 본사를 시작으로
캐나다 The Six Semi 및
미국 산호세 R&D 법인까지
글로벌 시스템 반도체 IP 설계
시장을 선도하기 위해
글로벌 반도체 설계 전문가들이
함께 노력하고 있습니다.

Richard Fung
TSS/CEO

AMD | PERASO

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사
'18~現 The Six Semiconductor CEO
'12~'18 Peraso Technologies Silicon Director 등
'00~'11 AMD PHY Analog Design Manager

Ricky Lau
TSS/CTO

AMD | SYNOPSYS

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사
'18~現 The Six Semiconductor CTO
'14~'18 Synopsys PHY Digital Design Engineer
'03~'14 AMD PHY Analog Design Engineer 등

Ron Chan
TSS/COO

pixelworks | ATI

Hong Kong Univ. IC Design 석사
'18~現 The Six Semiconductor COO
'06~'16 Pixelwork Principal Engineer
'01~'06 ATI Tech. Senior Engineer

Alan Poon
TSS/VP Engineering

AMD | PERASO

Univ. of Toronto 응용공학 석사
'19~現 The Six Semiconductor
Full Design Custom VP Engineering
'04~'19 Peraso Technology, AMD 등

Jason Mangattur
TSS/VP Engineering

AMD | SYNOPSYS | ATI

Waterloo Univ. 전자공학 학사
'22~現 The Six Semiconductor
Applied Eng.& IP Val. VP Engineering
'99~'21 Synopsys, AMD, ATI Tech. 등

Nisreen Atout
TSS/Director of Program Operations & System Engineering

Rambus | SEMTECH | AMD

Univ. of Toronto 전기공학 학사
'22~現 The Six Semiconductor Director of Program
Operations & System Engineering
'16~'22 Rambus Director of Systems Engineering
'06~'16 AMD, Semtech 등

Moez Cherif
OTC/Software Group Leader

ARTERIS IP | MAGMA | SYNOPSYS

INPG Univ. 컴퓨터과학 박사
'21~現 오픈엣지테크놀로지 미국법인 S/W그룹장
'18~'21 Arteris IP Principal S/W Architect
'95~'17 Synopsys, Magma Design Automation 등

Roger Jennings
OTC/ VP of Engineering

ARTERIS IP | AMD | intel

Univ. of Memphis 전자전기공학 석사
'22~現 오픈엣지테크놀로지 미국법인 VP of Engineering
'20~'22 Arteris IP Senior Director of Engineering
'02~'20 Intel, Juniper Networks, AMD 등

02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower - Global Presence

미국, 캐나다 해외 법인 외 글로벌 거점 확대

OPENEDGES Technology, Inc.

50% | 100% | 100%

Openedges Square

주요 역할	Online IP Sales Platform
설립 시기	'23년 8월

100%

Openedges Square Corporation

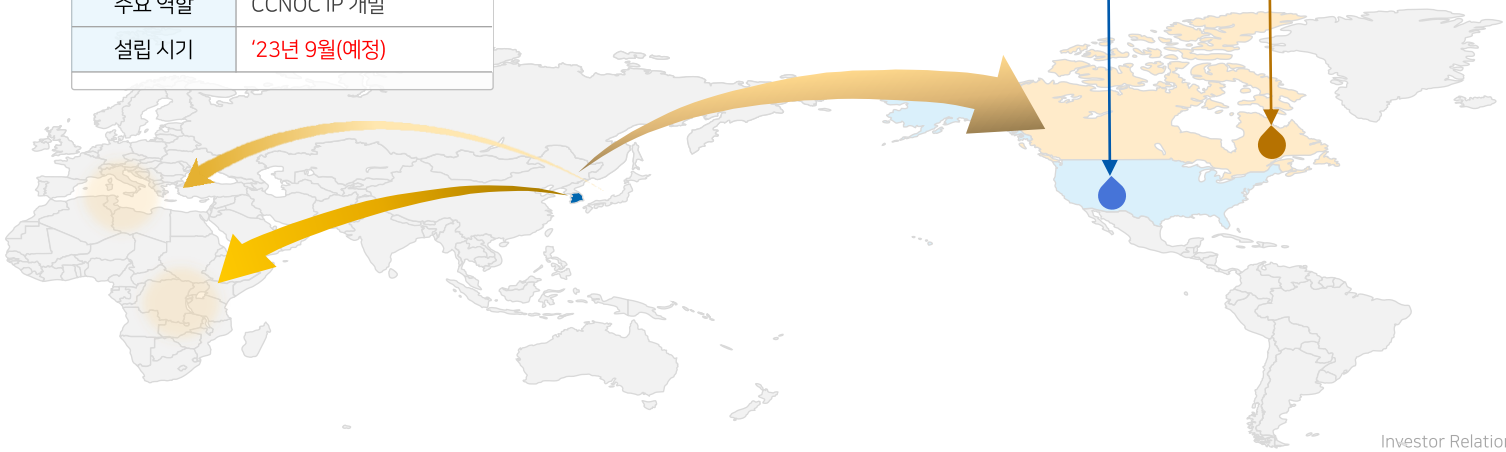
주요 역할	CCNOC IP 개발
설립 시기	'23년 9월(예정)

Openedges Technology Corporation

주요 역할	북미 지역 영업 거점
설립 시기	'21년 7월

The Six Semiconductor

주요 역할	DDR PHY IP 개발
설립 시기	'18년 6월

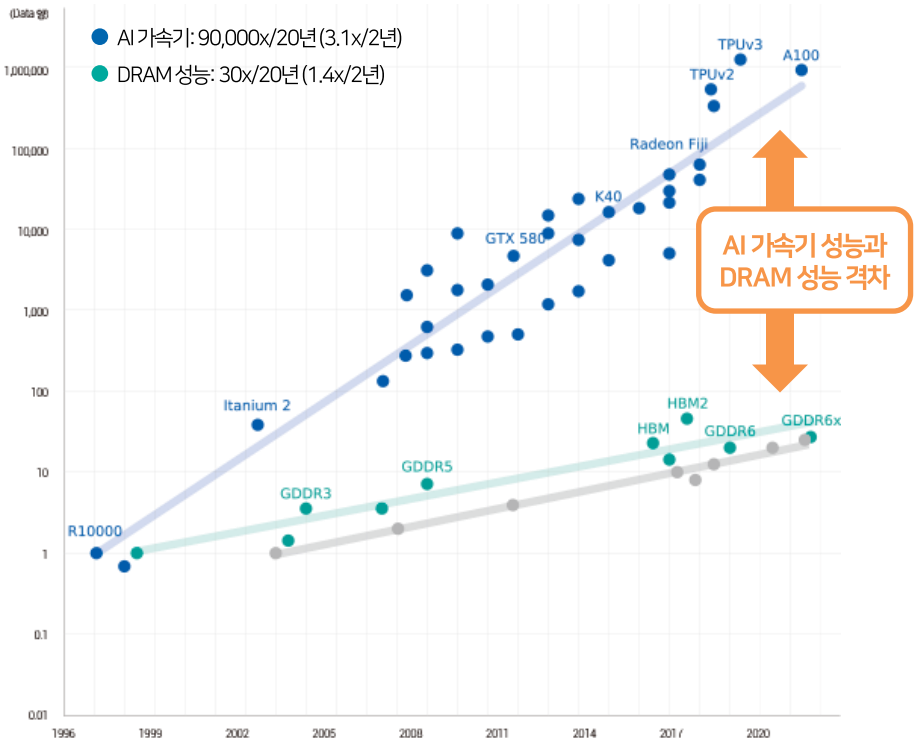


03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ①

OPENEDGES Technology, Inc.

AI 반도체는 'Data Intensive Computing'
→ 자원이 제약된 엣지 환경 아래 NPU와 메모리 시스템 최적화가 필수
오픈엣지는 글로벌 유일 AI 반도체 통합 IP 솔루션 공급 가능 업체

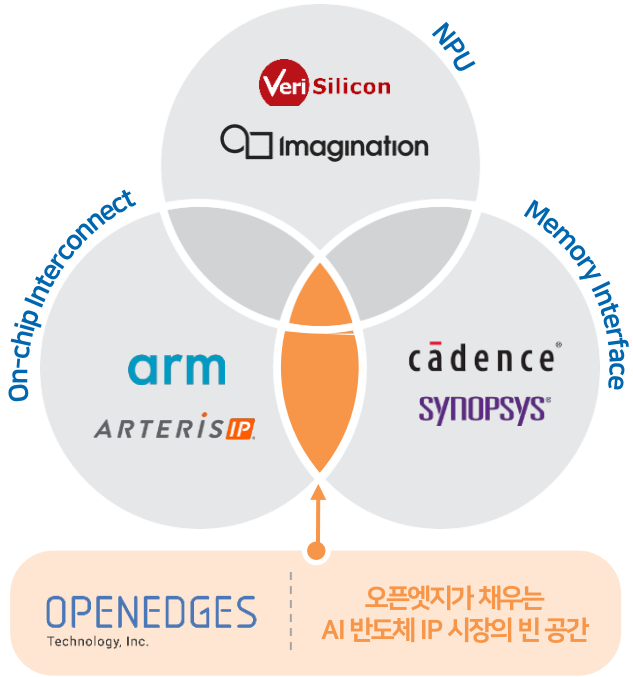
AI 가속기 기술 발전에 따라 Data 처리 요구량과 DRAM에서 제공하는 성능 간 격차 확대



※ 출처: AI And Memory Wall By Riselab

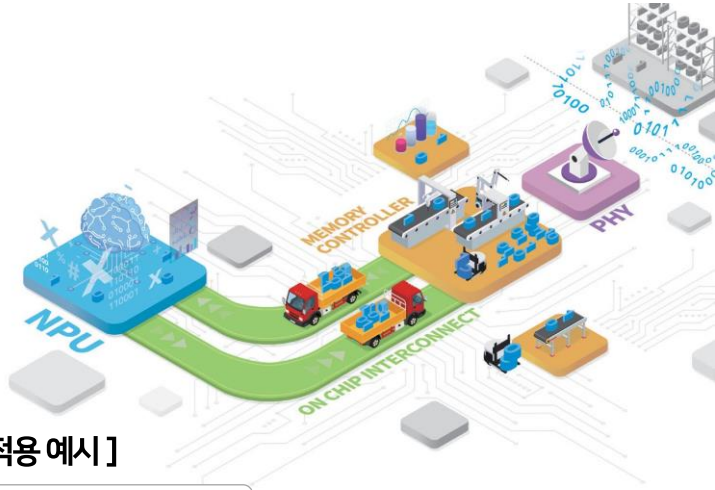
AI Platform IP for Edge Computing

오픈엣지는 AI 반도체의 핵심인 NPU IP와
모든 반도체의 'Back Bone' 역할을 하는 메모리 시스템 IP
동시 공급이 가능한 글로벌 유일한 회사



03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ②

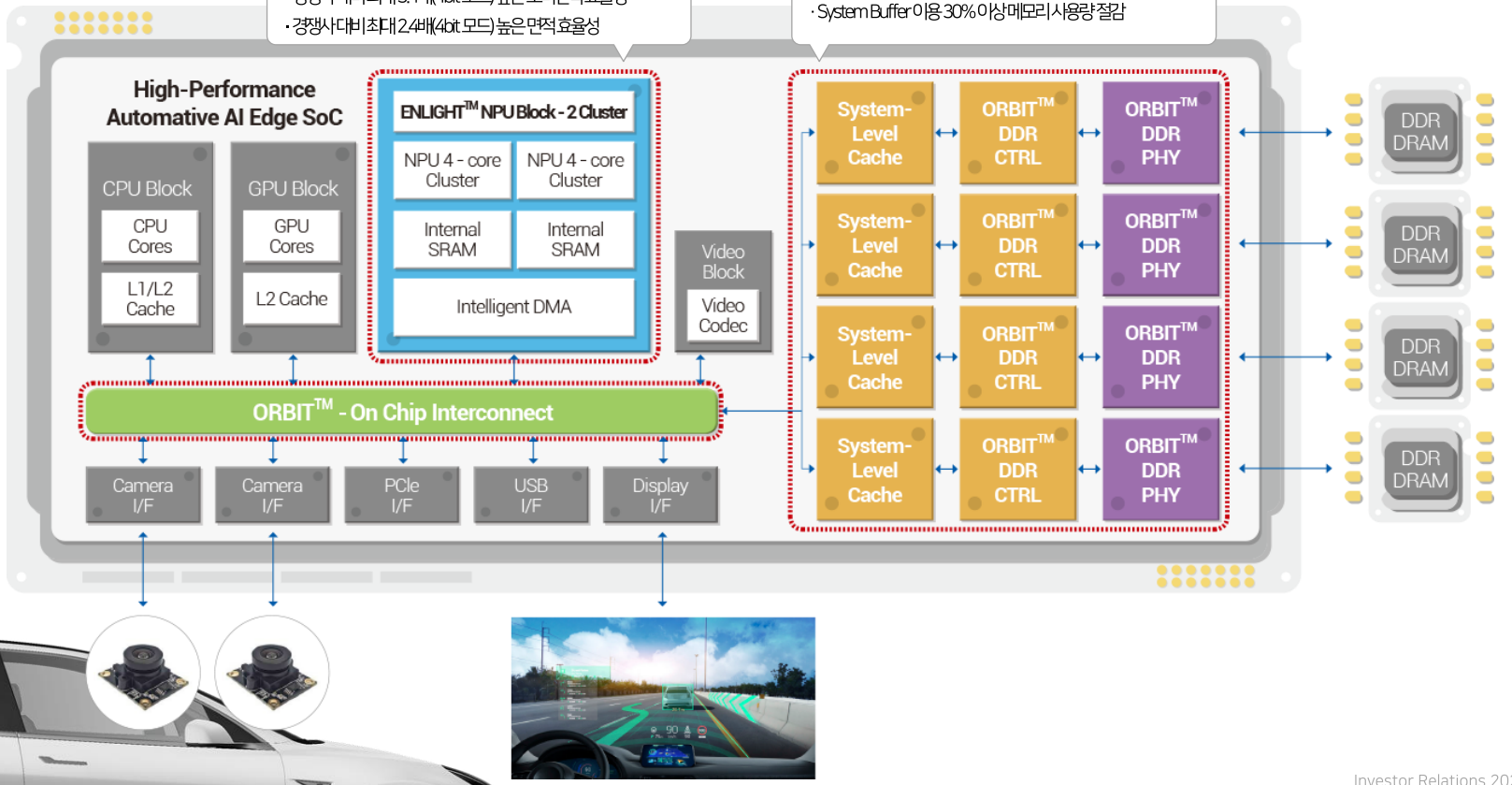
오픈엣지는 경쟁사 대비 높은 효율성을 (소비 전력 / 면적 / 메모리) 확보하여 AI 반도체 IP 기술을 선도



[당사 통합 IP솔루션의 자율주행 차량용 AI 반도체 적용 예시]

Openedges ENLIGHT™ NPU
- 경쟁사 대비 최대 3.4배(4bit 모드) 높은 소비전력 효율성
- 경쟁사 대비 최대 2.4배(4bit 모드) 높은 면적 효율성

Openedges ORBIT™ Memory System
- System Buffer 이용 30% 이상 메모리 사용량 절감



03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ③

OPENEDGES Technology, Inc.

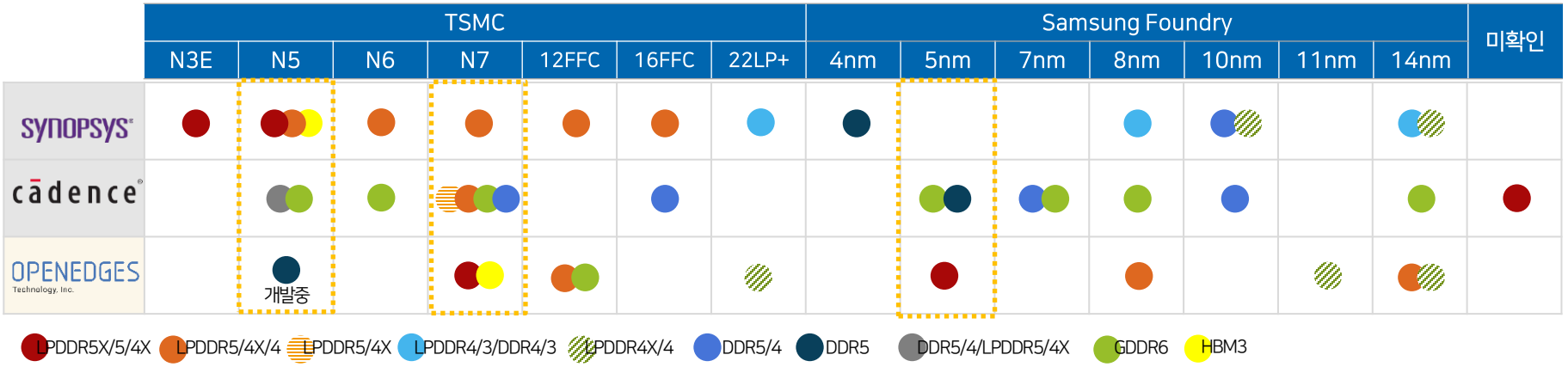
최선단 공정 중심 기술개발을 통한 시장선도 및 경쟁력 강화

구분	IP	Description	개발현황	Remark
AI Platform IP Solution for Edge Computing	ENLIGHT™ (Neural Processing Unit)	ENLIGHT™-L (1st gen. a.k.a v1.0)	Now	경량 IoT 응용제품 (키워드 인식, 보안카메라 급 응용)
		ENLIGHT™-R (2nd gen. a.k.a v2.0)	Now	중급 이상 IoT 응용제품 (자율주행 보조 급 응용)
		ENLIGHT™-P (3rd gen. a.k.a v3.0)	개발 중	차량용 고성능 응용제품 (레벨3급 이상 자율주행 차량 응용)
		ENLIGHT™-X (4th gen. a.k.a v4.0)	개발 예정	차량용 고성능 응용제품 (레벨4급 이상 자율주행 차량 응용, multi-die 버전)
Total Memory System Solution IP (ORBIT™)	OMC™ (DDR Memory Controller)	DDR4/3, LPDDR4X/4/3	Now	현재 Mainstream 기술
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	차세대 Mainstream 기술
		HBM3	Now	서버 및 초고성능 제품 향
		DDR5	Now	차세대 Mainstream 기술
		GDDR6	Now	고성능 AI 제품 향
		GDDR7	개발예정	차세대 고성능 AI 제품 향
		LPDDR6	개발예정	차세대 Mainstream 기술
	OPHY™ (DDR PHY)	LPDDR4X/4	Now	TSMC 22nm 공정용
		LPDDR4X/4, LPDDR5/4X/4	Now	TSMC 12nm 공정용
		GDDR6	Now	TSMC 12nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	TSMC 7nm 공정용
		HBM3	Now	TSMC 7nm 공정용
		DDR5	개발 중	TSMC 5nm 공정용
		LPDDR6	개발 예정	-
		LPDDR3, DDR4/3	Now	Samsung 28nm 공정용
		LPDDR4X/4, LPDDR5/4X/4	Now	Samsung 14nm 공정용
		LPDDR4X/4	Now	Samsung 11nm 공정용
		LPDDR5/4X/4	Now	Samsung 8nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	Samsung 5nm 공정용
		LPDDR6	개발 예정	-
		GDDR7	개발 예정	-
	OIC™ (On-Chip-Interconnect)	OIC™	Now	Non- Cache-Coherent NoC
		OIC™-AI	개발 중	Cache-Coherent NoC

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ④

글로벌 주요 경쟁사가 cover하지 못하는 영역에서 역량을 집중, 시장 점유율 확대

DDR PHY IP 경쟁 현황



- 글로벌 주요 IP 시장 참여자인 Synopsys와 Cadence는 TSMC 공정에서만 LPDDR5X/5용 PHY IP를 제공하고 있음
- 오픈엣지테크놀로지 TSMC N7 LPDDR5X용 PHY IP는 TSMC N6까지 확장 용이
- TSMC N5 DDR5용 PHY IP 개발 진행 중이며, IP협력방안 모색 중

오픈엣지테크놀로지 시장 점유율 확대 전략

- ✓ **LPDDR5X/5 용 PHY IP를 삼성파운드리 공정에서 주요 IP 벤더들 중 전세계 유일하게 지원**
- ✓ **다양한 패키지 타입에 맞게 적용 가능한 PHY IP를 제공함으로써 고객 편의성 극대화**
- ✓ **경쟁사 대비 50% 이하의 면적으로 구현한 test chip에서, 목표치 성능 입증 후 Silicon 검증된 PHY IP 제공**

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ⑤

OPENEDGES Technology, Inc.

최선단 공정의 지속 개발을 통해, AI 반도체 통합 IP 솔루션의 선점 효과를 극대화할 예정

예상 출시 일정		2021		2022		2023		2024		2025	
		1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
ENLIGHT™ Neural Processing Unit		NPU v1.0		NPU v2.0				NPU v3.0 Autonomous Driving		NPU4.0 Autonomous Driving	
		[성능] 0.25~2 TOPS / [타겟제품] 경량 IoT 응용제품 (키워드 인식, 보안카메라 응용)		[성능] 2~16 TOPS / [타겟제품] 중급 이상 IoT 응용제품 (자율주행 보조급 응용)		[성능] 16~250 TOPS / [타겟제품] 차량용 고성능 응용제품 (Level 3급 이상 자율주행차량 응용)		[성능] 250~1,000 TOPS / [타겟제품] 차량용 고성능 응용제품 (Level 4급 이상 자율주행 차량 응용 Multi-Die 버전)			
		보안 카메라		E-Mirror 등 운전자 지원 시스템				Self-Driving		완전 자율주행	
OIC™ On-Chip Interconnect	Non-Cache Coherent NOC	OIC v.1.X					OIC v.2.0				
	Cache Coherent NOC										OIC-AI
OMC™ Memory Controller		GDDR6	LP5X/5 /4X/4		HBM3	DDR5					
OPHY™ DDR PHY	SAMSUNG		LP4/4X/5 (14nm)				LP5X/5/4X (5nm)			LP5X/6 HBM3 (4nm)	
	tsmc			LP4/4X/5 GDDR6 (12nm)	LP4/4X/5 (22nm)	HBM3 LP4X/5/5X (7nm)			DDR5 (5nm)		
OPHY™ PHY Die to Die (Chiplet)	SAMSUNG									OPHY-D2D (5/8nm)	
	tsmc									OPHY-D2D (6nm)	

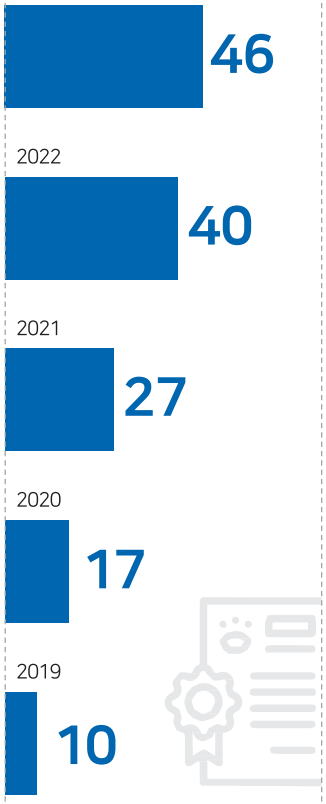
○ 2023년 R&D 착수 ○ 2024년~ R&D 착수

04 | 검증된 글로벌 Track Record

OPENEDGES Technology, Inc.

다양한 산업의 필수 솔루션으로 가치를 인정받아 글로벌 Track Record 확대 중

연도별 라이선스 체결 누적 거래건수



05 | 글로벌 기업과의 전략적 Partnership

OPENEDGES Technology, Inc.

안정적 IP 수요 확보 + 최신 기술 및 시장 트렌드에 대한 선도적 대응

*주1) SAFE (Samsung Advanced Foundry Ecosystem)

AI for Everyone, Everywhere

03

'23년 2분기 경영실적

01. 요약 재무제표
02. '23년 2분기 실적 분석
Appendix. Openedges Square Business Overview

01 | 요약 재무제표

OPENEDGES Technology, Inc.

IP 매출 확대로 전분기 비 매출이 크게 상승
1분기를 저점으로 분기 매출은 꾸준히 우 상향 할 것으로 기대

요약 재무상태표

(단위: 백만원)

	1H23	2022	2021	2020
유동자산	27,125	44,304	29,020	6,216
비유동자산	12,735	9,552	7,077	4,075
자산총계	**39,860**	**53,855**	**36,097**	**10,291**
유동부채	14,881	18,318	9,171	5,477
비유동부채	3,431	3,288	6,374	31,551
부채총계	**18,311**	**21,606**	**15,545**	**37,028**
자본금	2,137	2,116	1,653	15
자본잉여금	97,682	96,376	58,927	-
기타자본항목	3,186	2,026	3,007	1,697
이익잉여금	-81,457	-68,269	-43,035	-28,449
자본총계	**21,549**	**32,249**	**20,553**	**-26,737**

※ 연결 재무제표 기준

요약 손익계산서

(단위: 백만원)

	2Q23	1Q23	증감	증감(%)
영업수익	**2,842**	**1,059**	1,783	168.3
영업비용	8,422	8,801	-379	-4.3
영업이익	**- 5,581**	**- 7,742**	2,161	N/A
금융수익	319	415	-96	-23.2
금융비용	301	331	-30	-9.3
기타수익	10	43	-33	-75.8
기타비용	7	19	-12	-65.6
세전이익	**-5,559**	**-7,634**	2,075	*N/A*
법인세비용	-2	-4	2	*N/A*
당기순이익	**- 5,557**	**- 7,631**	2,074	*N/A*

※ 연결 재무제표 기준

02 | '23년 2분기 실적 분석

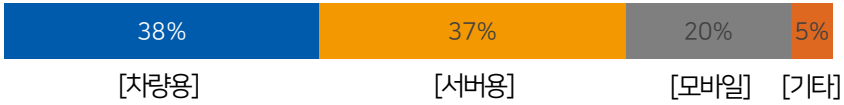
OPENEDGES Technology, Inc.

예상보다 계약 시기는 조금씩 이연 되었지만 꾸준히 수주가 이어질 것으로 기대
하반기는 상반기 대비 매출 규모가 대폭 증가할 것으로 예상됨

'23년 상반기 매출 분석

☐ 1분기를 저점으로 분기 매출은 꾸준히 우상향할 것으로 기대됨

- 상반기 Sector별 매출



- 상반기 지역별 매출

- 고객유형별 매출

☐ 수주현황

- 상반기에는 총 6건의 수주 계약을 체결함
- 총 6건의 수주 중 50%(3건)은 해외고객사와의 IP 계약
- 회사가 최근 확보한 최신 메모리 표준관련 IP들에 대한 수주문의가 활발히 진행 중에 있음
  * LPDDR5X, DDR5, HBM3 등

'23년 하반기 수주 및 매출 전망

☐ 기존 협상 중이던 PJT이외 새로운 IP 제공 문의 발생

- 최신 메모리 표준 관련 IP개발로 추가적인 수주문의 발생
- 기존 협의 중인 건을 포함, 현재 20개 이상 국내외 고객사와 수주협의 진행 중

'23.6월말 현재 수주 상황

	계약체결	PJT Drop	수주 Lost	잔존	합계
현황(건)	6 (22%)	0 (0%)	2 (7%)	21 (78%)	27 (100%)

☐ 최신 메모리 표준 관련 IP 수주에 따른 매출 확대 예상

- 복수 IP Total Solution 공급 + 최신 메모리표준 IP 높은 판가
- 하반기 빠른 수주 계약을 통한 연내 IP 제공을 위한 노력 중
- NPU v3, OIC v2(NCC-NoC), TSMC 5nm DDR5 PHY IP 등 IP 라인업 강화를 통한 내년도 매출 성장을 위한 노력도 함께 진행

OPENEDGES Technology, Inc.

Openedges Square Business Overview

AI 반도체 개발에 필수적인 반도체 IP 솔루션 + 차세대 반도체 설계 플랫폼의 개발 및 상업화를 목표로 오픈엣지스퀘어를 2023년 8월 설립

설립개요

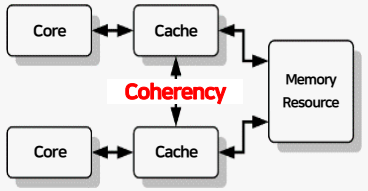
- ✓ **법인명 : OPENEDGES Square**
- ✓ **설립 자본금 : 360억원**
  - 오픈엣지 180억원(현물) + 재무적 투자자 180억원(현금)

    ※ 현물 출자대상은 법원에서 평가 진행 중
- ✓ **총 개발예산 : 430억원 (개발비 + 운영자금) ※ 현물 180억 포함 총 610억원**
  - 설립시 현금 180억원 외 250억원은 추가 출자 필요
- ✓ **이사회 구성(안) : 사내이사 2인, 기타비상무이사 2인**
  - 사내이사 : (CEO) 이성현 대표, (CTO) 황인조 상무 ※ 감사: 이우연 상무
  - 기타비상무이사 : 재무적 투자자 대표 2인
- ✓ **주요 사항 : 오픈엣지 HQ가 재무적투자자 지분 일부에 대해서는 콜옵션 보유예정**

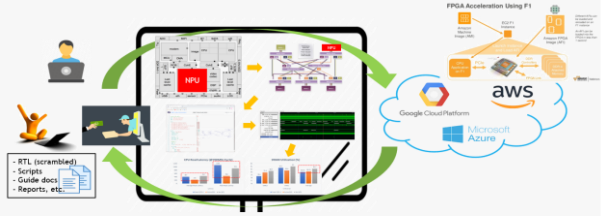
개발대상

1 Cache-coherent Network Solutions

AI Accelerator(멀티 코어) 간 cache data를 동일하게 유지하는 역할을 담당하는 AI반도체 내의 핵심 기능블록



기존 Openedges Technology 반도체 IP 사업과의 시너지를 통한 조기 상업화 및 안정적 성장을 목표

2 Web-based SoC Design Service

기존의 소모적인 SoC 설계 패러다임 혁신을 주도 가능한 Web 기반 설계 플랫폼/포털 개발 및 공급 (현재 경쟁사 없음)